博敏电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A41版）

公司生产所需主要原材料为覆铜板、铜箔、铜球、金盐、干膜、油墨和半固化片等，报告期各期主要原材料采购金额占各期原材料采购总额的比重均超过60%。

（四）行业竞争情况及公司的竞争地位

目前全球印制电路板制造企业约为3,000家，主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，行业较为分散，生产商众多，市场竞争较为充分。根据Prismark于2013年2月发布的全球PCB行业2012年第四季度研究报告显示，按照2012年全球PCB产业总产值543亿美元测算，全球前十大PCB生产企业的市场占有率约为31.97%，全球最大PCB企业市场占有率仅为4.85%，进一步表明全球PCB行业市场集中度不高的特点。

作为全球PCB产业最为重要的组成部分，我国印制电路板行业亦存在生产厂商众多、行业集中度低、单一企业市场份额较小的特点。根据CPCA出具的2012年度PCB百强排行榜统计显示，上榜企业2012年合计实现销售收入占全国PCB销售总额的57%，而榜单前10名企业销售收入合计仅占全国PCB产业销售总额的23.94%，排名第一的企业市场份额仅为3.86%。可见我国PCB行业竞争较为充分，不存在少数企业寡头垄断的情况。

经过多年积累和发展，公司已形成了完整的PCB全制程生产能力和合理的产品结构，并随着产品竞争力的不断提升，主营业务收入保持增长，市场占有率呈上升趋势。依照Prismark统计数据测算，2011-2013年度，我国PCB行业总产值按当期汇率均值折算人民币金额由1,386.66亿元上升至1,398.35亿元。公司市场占有率则由2011年的0.51%上升至2013年的0.70%，并入围全球著名PCB市场调研机构N.T. Information Ltd发布的2011年度、2012年度和2013年度全球印制电路板制造百强企业排名榜。

公司凭借多年技术积累形成的产品结构优势，始终坚持实施差异化产品竞争战略，报告期内，公司HDI板销售收入占公司主营业务收入的比例超过50%，且公司已掌握任意阶HDI产品的生产工艺技术并已开始批量生产。随着未来募集资金投资项目在江苏博敏的逐步投产，公司将在巩固和扩大HDI板市场占有率的同时，提升挠性电路板、刚挠结合板和任意阶HDI板等高新产品的生产能力，从而进一步加强自身在工艺技术水平和产品结构上的竞争优势，提升核心竞争力。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

本公司主要的固定资产为办公及开展经营活动所使用的房屋建筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备和办公设备及其他等，截至2014年12月31日，公司的固定资产状况如下表所示：

单位：万元

类别	账面原值（万元）	累计折旧（万元）	账面净值（万元）	成新率
房屋建筑物	19,500.15	1,936.78	17,563.37	90.07%
机器设备	68,108.63	18,159.67	49,948.95	73.34%
仪器仪表	568.63	228.10	340.53	59.89%
运输设备	645.12	431.50	213.62	33.11%
办公设备及其他	2,224.39	1,160.15	1,064.24	47.84%
合计	91,046.92	21,916.20	69,130.72	75.93%

截至本招股说明书摘要出具之日，公司拥有以及租赁的房屋及建筑物的具体情况如下：

1、公司拥有的房产

序号	房地产证编号	房屋坐落	用途	建筑面积（㎡）	地号	土地期限至	他项权利
1	粤房地权证梅州市字第0100029813号	梅州市东升工业园	厂房	1781.65	140220010085	2056/8/20	抵押
2	粤房地权证梅州市字第0100029814号	梅州市东升工业园	住宅	198.23	140220010038	2055/4/14	抵押
3	粤房地权证梅州市字第0100029815号	梅州市东升工业园	仓库	2340.00	140220010085	2056/8/20	抵押
4	粤房地权证梅州市字第0100029816号	梅州市东升工业园	厂房	4846.10	140220010038	2055/4/14	抵押
5	粤房地权证梅州市字第0100029817号	梅州市东升工业园	厂房	10845.81	140220010085	2056/8/20	抵押
6	粤房地权证梅州市字第0100029982号	梅州市东升工业园	住宅	529.23	140220010085	2056/8/20	抵押
7	粤房地权证梅州市字第0100029983号	梅州市东升工业园	办公楼	305.22	140220010038	2056/4/14	抵押
8	粤房地权证梅州市字第0100032837号	梅州市东升工业园	综合楼	4019.60	140220010130	2061/7/14	抵押
9	粤房地权证梅州市字第0100042469号	梅州市东升工业园	污水处理池	349.55	140220010085	2056/8/20	抵押
10	粤房地权证梅州市字第0100042470号	梅州市东升工业园	仓库	223.90	140220010085	2056/8/20	无
11	大丰房权证大中字第201500182号	大丰市开发区永圣路9号1楼	厂房	2806.57	050-053-0014000	2062/1/11	无

上述房产均为公司自建房产。此外，深圳博敏与深圳市宝安区住宅局于2014年11月28日签订深宝企字（2014）第067号《深圳市宝安区企业人才公共租赁住房买卖合同》，购买了5套企业人才公共租赁住房，建筑面积合计310.80平方米。

截至2014年12月31日，公司上述第1至第7处房产目前依法抵押给中国银行股份有限公司梅州分行，第8和第9处房产目前依法抵押给中国建设银行股份有限公司梅州市分行，为公司的贷款提供担保，其他房产未设置抵押或其他权利限制。

2、公司租赁的房产

序号	承租方	出租方	租赁物业	面积（㎡）	租金（元/月）	租赁用途	租赁期限
1	深圳博敏	深圳市白石厦股份合作公司	深圳市白石厦龙王庙工业园第21栋厂房一栋	4927.22	65,000	厂房	2011/12/20—2016/12/19
2			深圳市白石厦龙王庙工业园第22栋厂房一栋	4927.22	65,000	厂房	2011/12/20—2016/12/19
3			深圳市白石厦龙王庙工业园E栋宿舍楼一至二层	600	注1	宿舍	2011/1/1—2020/12/31
4	江苏博敏	上海合颖实业有限公司	上海市闵行区都会路2338号95栋六层	305	注2	办公室	2014/1/1—2016/12/31

注1：深圳博敏上述E栋宿舍楼租金约定为：2011年6月30日前，每月租金20,000元；2011年7月1日至2016年6月30日，每月租金22,000元；2016年7月1日至2020年12月31日，每月租金25,000元。

注2：每月租金为人民币13,725元；从2015年1月1日起，每年租金经双方协商并参照上一年度国家公布的经济增长率逐步调整。

截至本招股说明书摘要出具之日，由于历史原因，深圳博敏上述租赁物业未取得房屋产权证书。

（二）主要无形资产

截至2014年12月31日，公司无形资产账面价值为3,222.39万元，其中，土地使用权2,801.62万元，软件420.77万元。具体情况如下：

项目	账面原值（万元）	累计摊销（万元）	账面价值（万元）
土地使用权	3,001.58	199.96	2,801.62
软件	726.78	306.01	420.77
合计	3,728.36	505.97	3,222.39

此外，公司拥有的无形资产还主要包括专利、商标和软件著作权。

1、土地使用权

截至2014年12月31日，公司及其子公司已取得5宗土地使用权，使用面积合计198,327.00平方米。具体情况如下：

序号	证书编号	权利人	土地位置	地号	用途	面积（㎡）	土地终止日期	他项权利
1	粤房地权证梅州市字第0100029813号 粤房地权证梅州市字第0100029815号 粤房地权证梅州市字第0100029817号 粤房地权证梅州市字第0100029982号 粤房地权证梅州市字第0100042469号 粤房地权证梅州市字第0100042470号	博敏电子	梅州市东升工业园	140220010085	工业用地	26,405	2056/8/20	抵押 抵押 无
2	粤房地权证梅州市字第0100029814号 粤房地权证梅州市字第0100029816号 粤房地权证梅州市字第0100029983号	博敏电子	梅州市东升工业园	140220010038	工业用地	12,415	2055/4/14	抵押
3	粤房地权证梅州市字第0100032837号	博敏电子	梅州市东升工业园	140220010130	工业用地	305	2061/7/14	抵押
4	梅州市国用（2009）第0263号	博敏电子	梅州市东升工业园	140220010111	工业用地	4,087	2059/6/28	无
5	大土国用（2012）第0325号	江苏博敏	大丰市开发区	050-053-0014000	工业用地	155,115	2062/1/11	抵押

上述国有土地使用权系公司通过出让方式取得。

截至2014年12月31日，公司上述第1项土地使用权下的前4处房产和第2项土地使用权下的3处房产依法抵押给中国银行股份有限公司梅州分行，第1项土地使用权下的第5处房产和第3项土地使用权下的房产依法抵押给中国建设银行股份有限公司梅州市分行，为公司的贷款提供担保；公司第5项土地使用权依法抵押给江苏大丰农村商业银行，为公司的贷款提供担保。除前述外，公司其他土地使用权未设置抵押或其他权利限制。

2、专利

截至本招股说明书摘要出具之日，公司及其子公司拥有的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	申请日
1	印制线路板双面文字的印刷方法	ZL200910192814.9	发明专利	博敏电子	2009/9/29
2	无环盲孔高密度互连印制线路板板面整平的方法	ZL200910193882.7	发明专利	博敏电子	2009/11/12
3	印制线路板选择性镀金的制造方法	ZL201010141271.0	发明专利	博敏电子	2010/3/30
4	一种在多层电路板上加工管理孔的方法	ZL201110102240.9	发明专利	博敏电子	2011/4/22
5	一种嵌入式强电流大功率PCB板及其制作方法	ZL201110049119.4	发明专利	博敏电子、深圳博敏	2011/3/1
6	高密度互联印制电路板埋孔的塞孔方法	ZL201010573686.5	发明专利	博敏电子	2010/11/30
7	印制电路板的盲孔印刷阻焊的印刷方法	ZL201010597546.1	发明专利	博敏电子	2010/12/21
8	一种采取不同电流参数组合的电镀填盲孔方法	ZL201210124270.4	发明专利	博敏电子	2012/4/25
9	一种防止线路板铜层在硫酸铜镀铜溶液中被校蚀的方法	ZL201210124434.3	发明专利	博敏电子	2012/4/25
10	一种线路板塞孔树脂的研磨方法	ZL201210235180.2	发明专利	博敏电子	2012/7/9
11	印制电路板用的易排液体的电镀槽	ZL200920050349.0	实用新型	博敏电子	2009/1/16
12	一种节能降耗的螺杆空气压缩机	ZL200920051120.9	实用新型	博敏电子	2009/2/11
13	一种节能降耗的印制电路板用的磨板机	ZL200920051729.6	实用新型	博敏电子	2009/2/26
14	一种性能可靠的手摇平面磨床	ZL200920052119.8	实用新型	博敏电子	2009/3/6
15	一种散热快的印制电路板测试机用开关电源	ZL200920054009.5	实用新型	博敏电子	2009/3/30
16	印制电路板用的蚀刻药水参数稳定的蚀刻机	ZL200920057042.3	实用新型	博敏电子	2009/5/21
17	喷锡机用的电热管	ZL200920193999.0	实用新型	博敏电子	2009/9/3
18	印制线路板用的铜粉过滤机	ZL201020124614.8	实用新型	博敏电子	2010/3/5
19	一种数控钻孔机的主控制机箱	ZL201020170331.7	实用新型	博敏电子	2010/4/17
20	印制电路板用的镀金电镀槽	ZL201020202711.4	实用新型	博敏电子	2010/5/19
21	一种喷锡槽用加热块	ZL201020234936.8	实用新型	博敏电子	2010/6/18
22	电镀药水炭处理槽	ZL201120316931.4	实用新型	博敏电子	2011/8/26
23	可多点测量的温湿度检测装置	ZL201120331264.7	实用新型	博敏电子	2011/9/5
24	一种沉铜插板架	ZL201120363787.X	实用新型	博敏电子	2011/9/23
25	多用模具公顶板	ZL201120204134.7	实用新型	博敏电子	2011/6/16
26	沉铜子母篮	ZL201120454777.7	实用新型	博敏电子	2011/11/16
27	一种可伸缩的挡电边条	ZL201220007617.2	实用新型	博敏电子	2012/1/9
28	喷管装置	ZL201220007621.9	实用新型	博敏电子	2012/1/9
29	一种电路板的阳极遮板	ZL201220057170.X	实用新型	博敏电子	2012/2/21
30	一种分段打电流的电镀槽	ZL201220178669.6	实用新型	博敏电子	2012/4/24
31	一种电路板周转运输车	ZL201220490960.7	实用新型	博敏电子	2012/9/24
32	一种可移动的保温溶液槽	ZL201320283812.2	实用新型	博敏电子	2013/05/22
33	一种双相复合金属阳极杆	ZL201320284894.2	实用新型	博敏电子	2013/05/22
34	印制电路板用切片模具	ZL201320503673.X	实用新型	博敏电子	2013/08/16
35	一种线路板电镀用感应保护装置	ZL201320503713.0	实用新型	博敏电子	2013/08/16
36	组合式柔性印刷电路板贴合辅材治具	ZL201320697674.2	实用新型	博敏电子	2013/11/06
37	一种印制电路板生产用过滤装置	ZL201420115413.X	实用新型	博敏电子	2014/3/14
38	一种电镀用滤芯清洗装置	ZL201420284725.3	实用新型	博敏电子	2014/5/30
39	一种电路板用整板装置	ZL201420399207.6	实用新型	博敏电子	2014/7/20
40	一种印制电路板清洗用逆流水洗槽	ZL201420412724.5	实用新型	博敏电子	2014/7/24
41	一种可移动式铜球添加装置	ZL201420421098.3	实用新型	博敏电子	2014/7/29
42	一种改良型插板架	ZL201420615043.6	实用新型	博敏电子	2014/10/21
43	高频微波印制电路阻抗测试方法	ZL200710079667.5	发明专利	深圳博敏	2007/3/5
44	PCB板二次线路镀金工艺	ZL200910105993.8	发明专利	深圳博敏	2009/3/12
45	PCB板厚铜线路阻焊叠印工艺	ZL200910106638.2	发明专利	深圳博敏	2009/4/10
46	PCB板半孔加工工艺	ZL200910107109.4	发明专利	深圳博敏	2009/4/24
47	PCB印刷黑色阻焊的方法	ZL200910107108.X	发明专利	深圳博敏	2009/4/24
48	PTFE基板上印制阻焊的方法	ZL200910107272.0	发明专利	深圳博敏	2009/5/8
49	微带传输线阻抗参数测试方法	ZL200910192625.1	发明专利	深圳博敏、阳泽斌	2009/9/23
50	一种带盘中孔的高密度印制板的加工工艺	ZL201110115648.X	发明专利	深圳博敏	2011/5/4
51	一种带电插拔金手指PCB板的制作方法	ZL201110178016.8	发明专利	深圳博敏	2011/6/28
52	一种印制电路板锣刀自动铆套及取套装置	ZL201210543541.X	发明专利	深圳博敏	2012/12/13
53	一种高频微波印制板材介电常数的测试装置	ZL200820022698	实用新型	深圳博敏	2008/10/23
54	PCB分布参数阻抗测试电缆及配用的阻抗测试条	ZL200920050993.8	实用新型	深圳博敏、阳泽斌	2009/2/6
55	PCB薄板显影水平线帘引桥	ZL200920130454.5	实用新型	深圳博敏	2009/4/1
56	一种可剥兰胶漏板印刷装置	ZL200920130707.9	实用新型	深圳博敏	2009/4/10
57	一种PCB板过孔塞油装置	ZL200920130704.5	实用新型	深圳博敏	2009/4/13
58	防连冲的安全冲床	ZL200920130706.4	实用新型	深圳博敏	2009/4/13
59	印制电路板双面阻焊快速印刷制具	ZL201020195363.2	实用新型	深圳博敏	2010/5/14
60	一种PCB板电镀液添加剂添加装置	ZL201020195366.6	实用新型	深圳博敏	2010/5/14
61	一种新型PCB电镀镀缸	ZL201020195369.X	实用新型	深圳博敏	2010/5/14
62	印制电路板翻曲整平快捷车装置	ZL201020195379.3	实用新型	深圳博敏	2010/5/14
63	一种新型多功能防擦花转运车	ZL201120329119.5	实用新型	深圳博敏	2011/9/1
64	一种新型防漏风泵滴	ZL201120181907.4	实用新型	深圳博敏	2011/5/31
65	一种快速铆钉盯的套具	ZL201120307533.6	实用新型	深圳博敏	2011/8/19
66	一种超高导热性能的单面印制线路板	ZL201220617798.0	实用新型	深圳博敏	2012/11/20
67	一种印制电路板多功能测试工作台	ZL201220609379.2	实用新型	深圳博敏	2012/12/13
68	电镀设备电流密度实时监测装置	ZL201220609379.5	实用新型	深圳博敏	2012/12/13
69	一种电镀夹具	ZL201320393169.9	实用新型	深圳博敏	2013/06/27
70	一种防擦花PCB电铣成型装置	ZL201320470966.2	实用新型	深圳博敏	2013/07/25
71	一种多层板层压装置	ZL201320486821.1	实用新型	深圳博敏	2013/07/31
72	一种溶液定量补加装置	ZL201320487157.2	实用新型	深圳博敏	2013/08/01
73	一种无定位挂孔测试装置	ZL201320875616.4	实用新型	深圳博敏	2013/12/27
74	一种PCB电铣成型防堵塞的吸尘装置	ZL201420514741.7	实用新型	深圳博敏	2014/09/09
75	一种超长可伸缩防PCB变形的烘烤装置	ZL201420517686.7	实用新型	深圳博敏	2014/09/10
76	一种高散热LED线路板	ZL201420758008.X	实用新型	深圳博敏	2014/12/04
77	一种LED光源模组线路板	ZL201420762638	实用新型	深圳博敏	2014/12/08
78	一种柔性线路板连接结构	ZL201420762035	实用新型	深圳博敏	2014/12/11
79	一种用于印刷线路板塞孔的垫板及其使用方法	ZL201110107015.4	发明专利	江苏博敏	2011/4/27
80	一种易维护的真空包装机	ZL200920054187.8	实用新型	江苏博敏	2009/4/8
81	一种节能降耗的中央空调	ZL200920056292.5	实用新型	江苏博敏	2009/5/5
82	一种回收热能的螺杆式空气压缩机	ZL201020211590.X	实用新型	江苏博敏	2010/5/27
83	一种高压清洗机喷枪	ZL201020517684.X	实用新型	江苏博敏	2010/9/3
84	一种带有滑动盖板的PCB水平设备	ZL201420568800.9	实用新型	江苏博敏	2014/09/29
85	一种加工印制电路板装置	ZL201420582599.X	实用新型	江苏博敏	2014/10/09

公司及子公司拥有的专利权均为自主研发取得，不存在涉及诉讼的情况，不存在专利许可及授权使用的情形。

3、商标

截至本招股说明书摘要出具之日，公司及其子公司已有13项商标获得国家商标局的核准，具体情况如下表所示：

序号	商标图样	注册号	核定使用商品类别	注册人	注册有效期限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4、软件著作权

截至本招股说明书摘要出具之日，公司及其子公司共取得24项软件著作权，均为原始取得，具体情况如下表所示：

序号	软件名称	登记号	著作权人	取得方式	权利范围	首次发表日期	登记日期
1	用于Genesis2000的CAM自动化系统	2011SR035445	博敏电子	原始取得	全部权利	2010/11/15	2011/6/8
2	PCB工程管理系统V3.1.7	2012SR014324	博敏电子	原始取得	全部权利	2011/12/1	2012/2/28
3	PCB报价系统V1.0	2012SR067309	博敏电子	原始取得	全部权利	2012/6/1	2012/7/25
4	PCB人力资源管理系统V11.1.4.5	2012SR117270	博敏电子	原始取得	全部权利	2012/9/28	2012/12/1
5	出货与对账系统V3.0	2012SR133918	博敏电子	原始取得	全部权利	2012/10/30	2012/12/25
6	产品策划中心专用程序V1.0	2013SR145834	博敏电子	原始取得	全部权利	2013/1/4	2013/12/13
7	PCB样品管理系统V1.0	2013SR145529	博敏电子	原始取得	全部权利	2013/10/18	2013/12/13
8	PCB饭盒消费系统软件V1.0	2013SR145814	博敏电子	原始取得	全部权利	2013/10/18	2013/12/13
9	协同办公平台V1.0	2013SR145511	博敏电子	原始取得	全部权利	2013/9/30	2013/12/13
10	移动办公系统V3.6	2014SR205624	博敏电子	原始取得	全部权利	2013/11/1	2013/11/01
11	软板ERP系统V1.0	2014SR205609	博敏电子	原始取得	全部权利	2014/3/30	2014/04/05
12	FPC自动制作板边程序应用软件V1.0	2014SR130466	博敏电子	原始取得	全部权利	2014/6/18	2014/06/18
13	CAM组ODB++数据检测系统V1.0	2014SR131103	博敏电子	原始取得	全部权利	2014/6/18	2014/06/18
14	PCB考勤管理系统V1.0	2014SR205623	博敏电子	原始取得	全部权利	2014/7/1	2014/07/01
15	工艺成本核算系统V1.0	2014SR205625	博敏电子	原始取得	全部权利	2014/7/15	2014/07/15
16	ERP与K3对接系统V1.0	2014SR205621	博敏电子	原始取得	全部权利	2014/9/11	2014/09/11
17	PCB资料管理系统软件V1.0	2009SR014415	深圳博敏	原始取得	全部权利	2008/12/29	2009/4/10
18	PCB工程信息管理系统软件V1.0	2009SR014416	深圳博敏	原始取得	全部权利	2008/12/29	2009/4/10
19	PCB开料预算软件V1.0	2009SR014417	深圳博敏	原始取得	全部权利	2008/12/29	2009/4/10
20	PCB生产WIP分析运用系统V2.0	2011SR067130	深圳博敏	原始取得	全部权利	2011/5/31	2011/9/20
21	PCB生产工装器具管理系统V1.0	2012SR014584	深圳博敏	原始取得	全部权利	2011/5/31	2012/2/29
22	PCB工程信息管理系统软件V2.0	2012SR018448	深圳博敏	原始取得	全部权利	2011/11/15	2012/3/9
23	Genesis阻抗条测试模块制作软件V2.0	2012SR080629	深圳博敏	原始取得	全部权利	2012/4/10	2012/8/29
24	PCB企业人力资源及工时管理系统V1.0	2012SR080579	深圳博敏	原始取得	全部权利	2012/5/31	2012/8/29

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

本公司控股股东、实际控制人徐缓和谢小梅夫妇除持有本公司股权外，报告期内还实际控制鹏威公司，鹏威公司未实际开展经营，已于2013年6月7日完成注销，与本公司不存在同业竞争。除此之外，徐缓和谢小梅夫妇不存在其它对外投资，亦未直接或间接控制其他企业。因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人徐缓先生和谢小梅女士已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易情况

（1）销售商品、提供劳务情况

报告期内，公司关联销售的具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	定价方式及决策程序	2014年度		2013年度		2012年度	
			金额	占全部同类交易比例	金额	占全部同类交易比例	金额	占全部同类交易比例
宝得电子	销售水电	市价	-	-	-	-	148.98	100%
	加工费	市价	-	-	-	-	17.66	100%
	销售材料	市价	-	-	-	-	329.58	52.30%
正业科技	销售材料	市价	0.21	0.01%	0.43	0.13%	-	-
合计			0.21	-	0.43	-	496.22	-

报告期各期，公司向上述关联方关联销售或提供劳务的金额较小，且前述交易均按照市场价格进行。

（2）采购商品或接受劳务情况

报告期内，公司关联采购的具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	定价方式及决策程序	2014年度		2013年度		2012年度	
			金额	占全部同类交易比例	金额	占全部同类交易比例	金额	占全部同类交易比例
宝得电子	加工费	市价	-	-	-	-	982.73	9.80%
	采购材料	市价	-	-	-	-	11.43	0.01%
梅州市华泰工贸有限公司	采购办公用品	市价	0.91	0.36%	0.97	0.56%	0.94	0.42%
合计			0.91	-	0.97	-	995.10	-

公司在报告期各期向上述关联方采购商品、材料或接受劳务均按照市场价格进行，占报告期各期营业成本的比例较低，对公司经营成果影响较小。

（3）关联租赁情况

报告期内，公司关联租赁的具体情况如下：

单位：万元

出租方	承租方	租赁资产种类	报告期内租赁起至时间	租赁收益定价依据	2012年度租赁收益
博敏电子	宝得电子	房屋建筑物	2012年1-10月	市场定价	28.50

报告期内，公司向关联方收取的房屋租赁费用金额较小，占营业收入的比重也较低。宝得电子于2012年11月起不再租赁公司的房屋、建筑物。

（4）向董事、监事和高级管理人员支付薪酬

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目名称	2014年度	2013年度	2012年度
薪酬	490.84	465.50	420.74

2、偶发性关联交易

（1）接受关联方担保

报告期内，公司存在接受关联方担保的情形。截至报告期末，公司正在履行的关联担保情况如下：

单位：万元

序号	担保人	债务人	债权人	被担保债权(合同)	担保方式	合同金额
1	徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	博敏电子	中国银行梅州分行	发行人与债权人之间自2013年5月1日至2019年4月30日期间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务等合同	连带责任保证	18,000.00
2	徐缓、谢小梅	博敏电子	工商银行梅州分行	发行人与债权人在2011年9月1日至2016年9月1日签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议（合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件的全部债权	连带责任保证	5,000.00
3	徐缓、谢小梅	博敏电子	招行深圳新洲支行	发行人与债权人签订的2013年深字第0013931010号《授信协议》下的债权	保证担保	4,000.00
4	徐缓、谢小梅	博敏电子	交通银行梅州分行	发行人与债权人签订的粤交银梅2014年综字009号	连带责任保证	12,000.00
5	徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	博敏电子	广发银行梅州分行	发行人与债权人于2014年8月26日至2018年8月25日期间所签订的一系列合同及其修订或补充	连带责任保证	3,800.00
6	徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	博敏电子	建设银行梅州市分行	发行人与债权人签订的MZSP2014005的《出口商业发票融资业务合作协议书》	连带责任保证	3,000.00
				发行人与债权人签订的MZSP2014007号《出口商业发票融资业务合作协议书》		3,000.00
7	徐缓、谢小梅	深圳博敏	北京银行深圳香蜜支行	深圳博敏与债权人签订的《综合授信合同》(合同编号：0218039)项下的全部债权	连带责任保证	2,000.00
8	徐缓、谢小梅	深圳博敏	平安银行深圳分行营业部	深圳博敏与债权人签订的《综合授信合同》(合同编号：平银深分战贷字20140610第001号)项下的全部债权	连带责任保证	2,000.00
9	徐缓、谢小梅	江苏博敏	欧力士融资租赁(中国)有限公司深圳分公司	江苏博敏与融资租赁出租方签订的《融资租赁合同》(合同编号：L2014060073)	连带责任保证	1,766.43

上述关联方无偿为公司银行借款、贸易融资、保函、资金业务和融资租赁等提供相关担保，并且公司、深圳博敏和江苏博敏并未就此提供反担保。关联方为公司无偿提供担保未对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

（2）向关联方采购设备

报告期内，公司向广东正业科技股份有限公司采购激光切割机等设备及配件构成关联交易的金额分别为308.01万元、179.90万元和107.90万元。上述交易均按照平等互利、等价有偿的市场原则执行，交易金额较小、未对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

3、关联方往来

公司报告期末与关联方应收应付款项情况如下：

单位：万元

往来项目	关联方名称	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
应付账款	梅州市华泰工贸有限公司	0.19	0.52	0.38
应付账款	宝得电子	-	-	223.76
应付账款	正业科技	注	76.82	144.23
小计		0.19	77.34	368.37
应付票据	正业科技	注	60.48	-
小计		-	60.48	-

注：2014年6月起，正业科技不再是公司关联方。

（三）关联交易决策程序及批准情况

公司第一届董事会第七次会议、2011年度股东大会审议通过了《关于确认公司2011年度关联交易以及2012年度预计日常关联交易的议案》，对公司2011年度关联交易进行了确认，对2012年度预计日常关联交易进行审议，关联董事及股东回避表决该议案。

公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第四次会议、2012年第五次临时股东大会并通过了《关于确认关联交易事项的议案》，对公司2009年1月1日至2012年6月30日的关联交易事项进行了确认，关联董事及股东回避表决该议案，公司独立董事出具《博敏电子股份有限公司独立董事关于发行人关联交易公允性等问题的意见》，对公司2009年1月1日至2012年6月30日的关联交易事项发表意见：认为公司前述期限内发生的重大关联交易公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况；公司2009年1月1日至2012年6月30日发生的重大关联交易已经履行了法定批准程序。

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于确认公司2012年度关联交易及2013年度预计日常关联交易的议案》，确认公司2012年度关联交易的执行情况符合相关法议批准内容，且作价公允，未损害公司及中小股东利益，关联董事回避表决。

公司独立董事出具相关独立意见，确认发行人报告期内发生的关联交易已履行了法定批准程序，且价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方的采购和销售均按市场价格进行交易，占公司同类交易金额的比重低；关联方为公司提供担保，未收取费用。上述交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

七、董事、监事和高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况见下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况(万元)	直接持有公司股份数量(万股)
徐缓	董事长、总经理	男	48	2011.7~2017.6	曾任深圳博敏董事，博敏有限董事兼总经理，鹏威公司执行董事	深圳博敏总经理、江苏博敏执行董事、总经理；广东省印制电路行业协会副会长、深圳市线路板行业协会（SPCA）副会长、梅州市印制电路行业协会荣誉会长、CPCA副理事长、广东省客家商会常务理事、梅州市政协委员	81.74	5,083.30
谢建中	董事	男	55	2011.7~2017.6	曾任大新实业执行董事、总经理，博敏有